

MEMO

致 To : 各會員

編號 Ref. no. : M-13-070

由 From : HKPCA 秘書處

日期 Date : 2013年8月27日

2013年9月份培訓課程 2013 September Training Course

課題 Topic:	用於 HDI 板及 IC 載板生產的通孔填銅 Through-hole Cu filling for HDI and IC substrate production
日期 Date:	2013年9月27日(星期五) / September 27, 2013 (Friday)
時間 Time:	2:00-5:00 PM
地點 Venue:	東莞會展國際大酒店 1 號廳 Dongguan Exhibition International Hotel (中國廣東東莞新城區中心會展北路) (North Exhibition Road, New City Centre, Dongguan, Guangdong Province, P.R.C)
培訓目的 Training objective:	HDI 和 IC 載板生產應用的最新技術介紹 To introduce the latest technology applied for HDI and IC Substrate production
課程內容 Course Content:	1. 為什麼通孔填銅是 HDI 和 IC 載板生產中必要及重要的工藝? Why does the through-hole Cu filling become necessary and important for HDI and IC substrate production? 2. 在什麼時候強烈建議應用通孔填銅工藝? When is the through-hole Cu filling strongly recommended? 3. 與傳統技術相比, 通孔填銅技術有哪些優勢? What are the advantages of through-hole Cu filling, in comparison with traditional technology? 4. 通孔填銅技術目前的局限是什麼? What is the limitation of through-hole Cu filling technology at present? 5. 就工藝而言, 如何應用通孔填銅? How is the through-hole Cu filling applied, in terms of process? 6. 產品經過通孔填銅後的可靠性怎樣? How about the reliability is from through-hole Cu filling?
培訓對象 Target Audience:	HDI 及 IC 載板生產商 The manufacturers of HDI and IC substrate
講師 Information of speaker:	孫琦先生於 1996 年加入安美特化學有限公司, 目前他在電子部任產品經理。孫先生負責孔金屬化工藝中的除膠渣、沉銅和水平電鍍銅工藝的技術服務以及新產品的引進和應用。 Mr. Kelvin Suen joined Atotech in 1996 and currently works in the Electronics Division as Product Manager in Atotech HK/China. He is in charge of technical services, new products introduction and application for Desmear, PTH and Horizontal Copper Plating processes.
語言 Language:	中文 / Chinese

費用 Fee:	<p>本會會員 - 每位 HK\$370, 或 RMB300 (含稅) : 費用包括講義、茶點, 請於活動舉行前辦妥繳費事宜, 逾期作取消論。如屬同一公司多人報名, 可獲以下優惠 (此優惠只限公司會員) :</p> <p>3 人至 4 人 - 每位 HK\$320, 或 RMB250(含稅) 5 人或以上 - 每位 HK\$250, 或 RMB200(含稅)</p> <p>非本會會員 - 每位 HK\$570, 或 RMB450 (含稅) : 費用包括講義、茶點。</p> <p>Member - HK\$370, or RMB300 per head (including tax): The fee includes handouts and refreshments. Please settle the payment before the event, or reserved seats will be cancelled. If more than one people of the same company signed up for training, bulk discount will be offered (For corporate members only):</p> <p>3 to 4 persons- HK\$320, or RMB250 per head (tax included) 5 or more persons - HK\$250, or RMB200 per head (tax included)</p> <p>Non-members - HK\$570, or RMB450 per head (including tax): fee includes handouts, refreshments.</p>	
截止日期 Deadline:	2013 年 9 月 24 日(星期二) / September 24, 2013 (Tuesday)	
繳款辦法 Payment Method	<p>人民币电汇 :</p> <p>户 名 : 港粵綫路板科技咨询(深圳)有限公司 开户行 : 招商银行股份有限公司深圳常兴支行 帐 号 : 7559 1878 8810 201 深圳秘书处地址: 中国广东省深圳市南山区桃园路 171 号深圳发展银行南山大厦 13A2 室</p>	<p>港幣電匯 :</p> <p>銀行名稱 : 香港上海滙豐銀行有限公司 帳戶名稱 : 香港綫路板協會有限公司 帳戶號碼 : 469-089601-838 銀行電匯編號 : HSBCHKHCHKH 香港辦事處地址 : 香港九龍觀塘成業街 7 號寧晉中心 22 樓 B 室</p> <p>Bank name : HSBC Bank A/C Name: Hong Kong Printed Circuit Association Ltd. Bank A/C No: 469-089601-838 Swift Code: HSBCHKHCHKH Hong Kong Office Address: Unit B, 22/F., Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, H.K.</p>
查 詢 Enquiry:	<p>深圳秘書處: 吳小姐 Lisa Wu; Tel: (86) 755 8624 1675; Email: lisawu@hkpca.org 袁小姐 Susan Yuan; Tel: (86) 755 8624 1673;</p>	

[回條見下頁->](#)

回條 Reply Form

2013 年 9 月份培訓課程

日期：2013 年 9 月 27 日 (星期五)

時間：14:00 ~ 17:00

地點：東莞會展國際大酒店 1 號廳

請於 2013 年 9 月 24 日(週二)前回覆

Please reply by Sept. 24 (Tuesday), 2013

傳真 Fax : 755-86240022

電郵 Email : lisawu@hkpca.org

致：HKPCA/PRC 秘書處

本人/吾等希望參加 2013 年 9 月 27 日培訓課程

本人/本公司為 HKPCA 會員，會員編號：_____。

參加者詳情：

人數	參加者姓名(必填)		職位	參加培訓者	學歷 (請選擇一項)			是否需要培訓證
	英文	中文		手機號(必填)	預科或以下	大專或大學	碩士或博士	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

說明：

1、需要培訓證的學員請在「是否需要培訓證」一欄中進行選擇，並填妥中英文名，無中文名的除外。

2、培訓證將在當次培訓課程結束後，發放給學員本人；若參加者有變動請於截止日期前通知本會。

3、使用培訓優惠卷號碼：_____

對是次課程之期望 (請務必填寫)：_____

其他：_____

費用：

參加人數共 _____ 人 X 每人港幣/人民幣 \$ _____ = 合共總額港幣/人民幣 \$ _____

備註：不設現場收費，煩請於課程至少三天前付清。

聯絡人資料：

公司名稱：_____

公司地址：_____

姓名：_____ 電話：_____

電郵：_____ 傳真：_____

截止報名日期: 2013 年 9 月 24 日(星期二)